

第7世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載 PCI-Express (x16)×1、PCI×1、USB3.0×6、COM×4装備

RCS-9211H

- 第7世代 インテル® Core™ プロセッサ / インテル® Xeon® E3 プロセッサを搭載可能
- インテル® C236 チップセット装備
- PCI-Express (x16)×1基、PCI×1基装備
- USB3.0×6基装備
- COMポート×4基装備
- 6V~36V DC-in
- 32 DIO(16 DI、16 DO)装備
- 最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応 ※35W TDP CPU搭載時
- Windows 7搭載可能 ※オプション
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



レガシー構成での継続運用を可能にする拡張性

RCS-9211Hには、主なI/OにCOMを4基、USB3.0を6基を装備し、拡張スロットにはPCI-Express x16とPCIを装備することでレガシータイプの拡張ボードを搭載することが可能。さらにOSにはWindows 7搭載可能。既存にあるレガシー構成での継続運用を可能にします。

ファンレスで耐環境性能に優れた設計

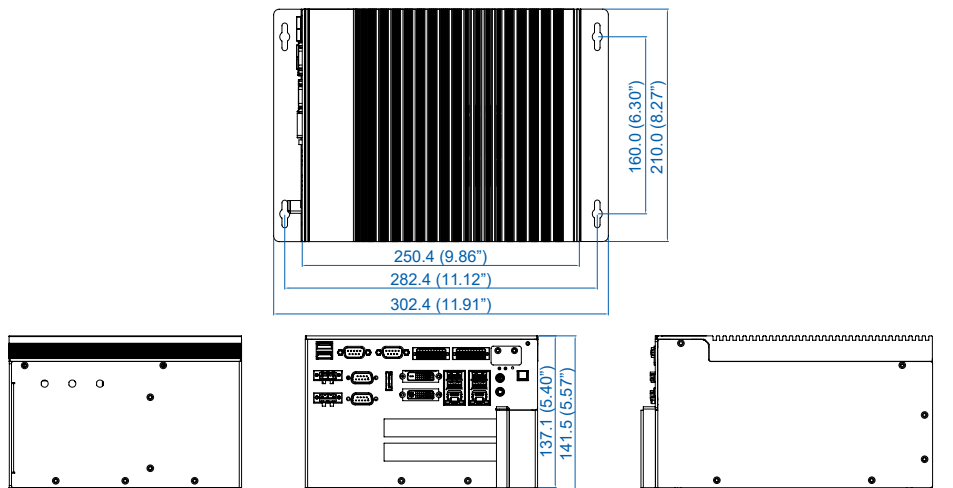
最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応(拡張ボード搭載無し時)し、また筐体がファンレス構造によりチリやホコリが多くて厳しい過酷な環境下でも安定性動作を可能にします。

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名		RCS-9211H
プロセッサ	種類	第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー インテル® Xeon® E プロセッサ・ファミリー
	搭載数	1
チップセット		インテル® C236 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2400MHz SO-DIMM
	容量	最大32GB
	スロット数	2
ストレージ	2.5" SSD/HDD	2 (内部)
	CFast	1 (内部)
SIMカードソケット		3 (外部2、内部1)
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス
I/O	シリアル (COM)	4 (RS-232/422/485)
	USB	6 (USB3.0)
	DIO	絶縁型32 (16 DI, 16 DO)
	DisplayPort	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	DVI-I	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	DVI-D	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	Ethernet (1GbE)	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN, iAMT 11.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN
拡張スロット	PCI-Express	PCI-Express x16スロット×1
	Mini PCI-Express	2 フルサイズ (PCI-Express/USB/External SIM Card用) 1 フルサイズ (PCI-Express/USB/External SIM Card/mSATA用)
	PCI	1
オーディオ	コーデック	Realtek ALC888S-VD, 7.1 Channel HD Audio
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	6V~36V, DC-in
	ACアダプター	オプション 120W ACアダプター (PSE認証, 24V, 90W AC~264V AC, 0°C~+40°C対応) 160W ACアダプター (PSE認証, 24V, 85V AC~264V AC, -30°C~+70°C対応) 280W ACアダプター (PSE認証, 24V, 85V AC~264V AC, -30°C~+70°C対応) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block: V+, V-, Frame Ground
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
	サージ保護	過渡電圧:最大80V/1ms
外観寸法 (W × L × H)		137mm × 250mm × 210mm (突起物等を除く)
重量		約4.3kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット
利用環境	動作温度	35W TDP CPU :Xeon® E3-1268L v5 :-40°C~+70°C、Core™ i7, i5, i3 : -40°C~+75°C 65W TDP CPU :Core™ i7, i5, i3 : -40°C~+55°C 80W TDP CPU :Xeon® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C~+45°C
	保存温度	-40°C~+85°C
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27 SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis
	EMC指令	CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon Inside, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2021年8月現在の内容です。